



-  Processeur INTEL Skylake I7 6700
-  INTEL Skylake Q170
-  2 SODIMM DDR4 32 GB Max
-  Solution ventilée
-  1 VGA • 1 HDMI
-  4 RS232 • 10 USB
-  4 ports gigabit Ethernet
-  Alimentation 12V~24V (Connecteur PHOENIX)



## Système

<b>Chipset</b>	Intel Skylake Q170
<b>Processeur</b>	Core I7 6700 ( 4 cœurs / 8 Threads ) • 3.40 Ghz • 65 Watts
<b>Vidéo</b>	INTEL HD 530
<b>Mémoire</b>	2 SODIMM DDR4 PC3200 ( 32 GB Max )
<b>Expansion</b>	3 miniPCIe • 2 PCIe x 8 • 1 PCIe x 1 • 1 M.2
<b>Disque dur</b>	1 2.5 " • 1 M.2 Type 2242
<b>Port série</b>	4 RS232 / 422 / 485 • 1 externe • 3 interne
<b>Audio</b>	Non
<b>USB</b>	Intel Skylake Q170
<b>Ethernet</b>	4 Lan INTEL I210 ( 2 LAN I210 supp. en option) • 1 Lan INTEL I219
<b>Alimentation AC/DC</b>	12V~24V DC ( Connecteur PHOENIX)
<b>TDP</b>	Environ 80 Watts

## I/O

<b>Vidéo</b>	1 VGA & 1 HDMI
<b>USB</b>	4 USB 3.1 • 4 USB 2.0 (externe) • 2 USB 2.0 (interne)
<b>RS232</b>	4 RS232 / 422 / 485 • 1 externe • 3 interne
<b>RJ45</b>	4 Lan INTEL I210 ( 2 LAN I210 supp. en option) • 1 Lan INTEL I219
<b>Audio</b>	Non
<b>DIO</b>	4 DI / 4DO.

**Environnement**

<b>Temp. Fonctionne.</b>	-20°C ~ + 70°C
<b>Temp. Stockage</b>	-20°C ~ + 85°C
<b>Humidité</b>	5% ~ 95%
<b>Sécurité</b>	FCC, CE

**Mécanique**

<b>Construction</b>	Aluminium / Métal
<b>Dimensions</b>	260 x 171 x 212 mm
<b>Poids</b>	4 Kg
<b>Sécurité</b>	2 supports de fixations

